

2014年10月31日

# 2015年3月期 上期 決算説明会

代表取締役社長  
山口 悟郎

## 2015年3月期 上期 決算概要（前年同期比）

（単位：百万円）

	2014年3月期 上期		2015年3月期 上期		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
売上高	699,663	100.0%	<b>714,329</b>	<b>100.0%</b>	14,666	2.1%
営業利益	58,203	8.3%	<b>54,751</b>	<b>7.7%</b>	-3,452	-5.9%
税引前四半期純利益	69,053	9.9%	<b>68,118</b>	<b>9.5%</b>	-935	-1.4%
四半期純利益	42,930	6.1%	<b>43,649</b>	<b>6.1%</b>	719	1.7%
設備投資額	28,607	4.1%	<b>30,470</b>	<b>4.3%</b>	1,863	6.5%
減価償却費	29,873	4.3%	<b>28,419</b>	<b>4.0%</b>	-1,454	-4.9%
研究開発費	24,180	3.5%	<b>26,480</b>	<b>3.7%</b>	2,300	9.5%
平均為替レート	ドル	99円	<b>103円</b>			
	ユーロ	130円	<b>139円</b>			
為替変動による影響額 （前年同期比）	売上高	約 790億円	<b>約 190億円</b>			
	税引前四半期純利益	約 160億円	<b>約 50億円</b>			

## 2015年3月期 上期 事業セグメント別売上高（前年同期比）

（単位：百万円）

	2014年3月期 上期		2015年3月期 上期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
ファインセラミック部品関連事業	38,187	5.5%	<b>43,224</b>	<b>6.0%</b>	5,037	13.2%
半導体部品関連事業	87,063	12.4%	<b>102,173</b>	<b>14.3%</b>	15,110	17.4%
ファインセラミック応用品関連事業	127,515	18.2%	<b>124,714</b>	<b>17.5%</b>	-2,801	-2.2%
電子デバイス関連事業	147,451	21.1%	<b>138,843</b>	<b>19.4%</b>	-8,608	-5.8%
部品事業 計	400,216	57.2%	<b>408,954</b>	<b>57.2%</b>	8,738	2.2%
通信機器関連事業	96,557	13.8%	<b>91,555</b>	<b>12.8%</b>	-5,002	-5.2%
情報機器関連事業	144,525	20.7%	<b>157,648</b>	<b>22.1%</b>	13,123	9.1%
機器事業 計	241,082	34.5%	<b>249,203</b>	<b>34.9%</b>	8,121	3.4%
その他の事業	79,713	11.4%	<b>83,457</b>	<b>11.7%</b>	3,744	4.7%
調整及び消去	-21,348	-3.1%	<b>-27,285</b>	<b>-3.8%</b>	-5,937	—
売上高	699,663	100.0%	<b>714,329</b>	<b>100.0%</b>	14,666	2.1%

## 2015年3月期 上期 事業セグメント別事業利益（前年同期比）

（単位：百万円）

	2014年3月期 上期		2015年3月期 上期		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
ファインセラミック部品関連事業	5,762	15.1%	<b>7,009</b>	<b>16.2%</b>	1,247	21.6%
半導体部品関連事業	16,041	18.4%	<b>14,655</b>	<b>14.3%</b>	-1,386	-8.6%
ファインセラミック応用品関連事業	14,834	11.6%	<b>5,776</b>	<b>4.6%</b>	-9,058	-61.1%
電子デバイス関連事業	14,662	9.9%	<b>16,684</b>	<b>12.0%</b>	2,022	13.8%
部品事業 計	51,299	12.8%	<b>44,124</b>	<b>10.8%</b>	-7,175	-14.0%
通信機器関連事業	266	0.3%	<b>-1,258</b>	—	-1,524	—
情報機器関連事業	10,449	7.2%	<b>17,207</b>	<b>10.9%</b>	6,758	64.7%
機器事業 計	10,715	4.4%	<b>15,949</b>	<b>6.4%</b>	5,234	48.8%
その他の事業	2,001	2.5%	<b>2,494</b>	<b>3.0%</b>	493	24.6%
事業利益 計	64,015	9.1%	<b>62,567</b>	<b>8.8%</b>	-1,448	-2.3%
本社部門損益等	5,038	—	<b>5,551</b>	—	513	10.2%
税引前四半期純利益	69,053	9.9%	<b>68,118</b>	<b>9.5%</b>	-935	-1.4%

# 2015年3月期 上期決算要約（前年同期比）

## 上期として過去最高の売上高、税引前利益はほぼ横ばい

### 1. 部品事業の拡大

- 通信市場：通信インフラやスマートフォン向けセラミックパッケージ、コンデンサ
- 自動車市場：カメラモジュール、LED用セラミックパッケージ、機械工具
- 京セラサーキットソリューションズの寄与による有機基板事業の拡大

### 2. 情報機器関連事業の拡大

- 複合機の販売増による増収
- 消耗品等の売上増によるプロダクトミックスの改善及び原価低減による利益増

### 3. 電子デバイス関連事業の増益

原価低減や前期に実施した構造改革の効果

### 4. ファインセラミック応用品関連事業の収益減

ソーラーエネルギー事業における大型案件の減少や価格下落の影響

# 2015年3月期 第2四半期 決算概要（第1四半期比）

（単位：百万円）

	2015年3月期				増減	
	第1四半期		第2四半期		金額	率
	金額	売上高比	金額	売上高比		
売上高	334,714	100.0%	<b>379,615</b>	<b>100.0%</b>	44,901	13.4%
営業利益	18,782	5.6%	<b>35,969</b>	<b>9.5%</b>	17,187	<b>91.5%</b>
税引前四半期純利益	30,680	9.2%	<b>37,438</b>	<b>9.9%</b>	6,758	22.0%
四半期純利益	19,467	5.8%	<b>24,182</b>	<b>6.4%</b>	4,715	24.2%
設備投資額	14,984	4.5%	<b>15,486</b>	<b>4.1%</b>	502	3.4%
減価償却費	13,562	4.1%	<b>14,857</b>	<b>3.9%</b>	1,295	9.5%
研究開発費	13,050	3.9%	<b>13,430</b>	<b>3.5%</b>	380	2.9%
平均為替レート	ドル	102円	<b>104円</b>			
	ユーロ	140円	<b>138円</b>			
為替変動による影響額 （直前四半期比）	売上高	—	<b>約 20億円</b>			
	税引前 四半期純利益	—	<b>約 0億円</b>			

# 2015年3月期 第2四半期 事業セグメント別売上高（第1四半期比）

（単位：百万円）

	2015年3月期				増減	
	第1四半期		第2四半期		金額	率
	金額	構成比	金額	構成比		
ファインセラミック部品関連事業	20,852	6.2%	<b>22,372</b>	<b>5.9%</b>	1,520	7.3%
半導体部品関連事業	48,464	14.5%	<b>53,709</b>	<b>14.2%</b>	5,245	10.8%
ファインセラミック応用品関連事業	53,809	16.1%	<b>70,905</b>	<b>18.7%</b>	17,096	31.8%
電子デバイス関連事業	66,187	19.8%	<b>72,656</b>	<b>19.1%</b>	6,469	9.8%
部品事業 計	189,312	56.6%	<b>219,642</b>	<b>57.9%</b>	30,330	<b>16.0%</b>
通信機器関連事業	38,515	11.5%	<b>53,040</b>	<b>14.0%</b>	14,525	37.7%
情報機器関連事業	77,482	23.2%	<b>80,166</b>	<b>21.1%</b>	2,684	3.5%
機器事業 計	115,997	34.7%	<b>133,206</b>	<b>35.1%</b>	17,209	<b>14.8%</b>
その他の事業	41,614	12.4%	<b>41,843</b>	<b>11.0%</b>	229	0.6%
調整及び消去	-12,209	-3.7%	<b>-15,076</b>	<b>-4.0%</b>	-2,867	—
売上高	334,714	100.0%	<b>379,615</b>	<b>100.0%</b>	44,901	13.4%

# 2015年3月期 第2四半期 事業セグメント別事業利益（第1四半期比）

（単位：百万円）

	2015年3月期				増減	
	第1四半期		第2四半期			
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
ファインセラミック部品関連事業	3,355	16.1%	<b>3,654</b>	<b>16.3%</b>	299	8.9%
半導体部品関連事業	5,655	11.7%	<b>9,000</b>	<b>16.8%</b>	3,345	59.2%
ファインセラミック応用品関連事業	2,820	5.2%	<b>2,956</b>	<b>4.2%</b>	136	4.8%
電子デバイス関連事業	7,664	11.6%	<b>9,020</b>	<b>12.4%</b>	1,356	17.7%
部品事業 計	19,494	10.3%	<b>24,630</b>	<b>11.2%</b>	5,136	26.3%
通信機器関連事業	-3,584	—	<b>2,326</b>	<b>4.4%</b>	5,910	—
情報機器関連事業	7,603	9.8%	<b>9,604</b>	<b>12.0%</b>	2,001	26.3%
機器事業 計	4,019	3.5%	<b>11,930</b>	<b>9.0%</b>	7,911	196.8%
その他の事業	642	1.5%	<b>1,852</b>	<b>4.4%</b>	1,210	188.5%
事業利益 計	24,155	7.2%	<b>38,412</b>	<b>10.1%</b>	14,257	59.0%
本社部門損益等	6,525	—	<b>-974</b>	<b>—</b>	-7,499	—
税引前四半期純利益	30,680	9.2%	<b>37,438</b>	<b>9.9%</b>	6,758	22.0%



# 2015年3月期 第2四半期 決算要約（第1四半期比）

## 全てのセグメントで増収増益、事業利益は約6割の大幅増益

### 1. 重点市場での売上増

- スマートフォン: CMOSイメージセンサー用や水晶・SAWデバイス用セラミックパッケージ、コネクタ、コンデンサ
- 自動車等産業市場: 機械工具、カメラモジュール、半導体製造装置用部品

### 2. 通信機器関連事業の収益増

新製品効果による大幅な売上増、利益改善

### 3. 情報機器関連事業の収益増

欧州を中心にプリンター及び複合機の販売増、利益増

### 4. 太陽電池需要の拡大

国内産業向けの販売増に伴う売上増

# 2015年3月期 業績予想

(単位：百万円)

	2014年3月期		2015年3月期予想				増減金額	
			前回予想 (4月時点)		今回予想 (10月時点)			
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	売上高比	前期比	前回予想比
売上高	1,447,369	100.0%	1,580,000	100.0%	<b>1,580,000</b>	<b>100.0%</b>	132,631	—
営業利益	120,582	8.3%	135,000	8.5%	<b>135,000</b>	<b>8.5%</b>	14,418	—
税引前当期純利益	146,268	10.1%	158,000	10.0%	<b>158,000</b>	<b>10.0%</b>	11,732	—
当期純利益	88,756	6.1%	97,000	6.1%	<b>97,000</b>	<b>6.1%</b>	8,244	—
EPS (円)	241.93	—	264.40	—	<b>264.40</b>	—	22.47	—
設備投資額	56,611	3.9%	64,000	4.1%	<b>64,000</b>	<b>4.1%</b>	7,389	—
減価償却費	65,760	4.5%	71,000	4.5%	<b>65,000</b>	<b>4.1%</b>	-760	-6,000
研究開発費	48,830	3.4%	54,000	3.4%	<b>54,000</b>	<b>3.4%</b>	5,170	—
平均為替レート	ドル	100円	100円	<b>104円</b>				
	ユーロ	134円	137円	<b>137円</b>				
為替変動による影響額 (前期比)	売上高	約 1,400億円	約 50億円	<b>約 240億円</b>				
	税引前当期純利益	約 290億円	約 20億円	<b>約 40億円</b>				

(注) 1 2015年3月期今回予想のEPSは、2015年3月期上期の希薄化後の期中平均株式数を用いて算出しています。

2 EPSは2013年10月1日に実施した株式分割 (普通株式1株を2株に分割) を、2014年3月期の期首 (2013年4月1日) に実施したと仮定し算出しています。

# 2015年3月期 事業セグメント別売上高予想

(単位：百万円)

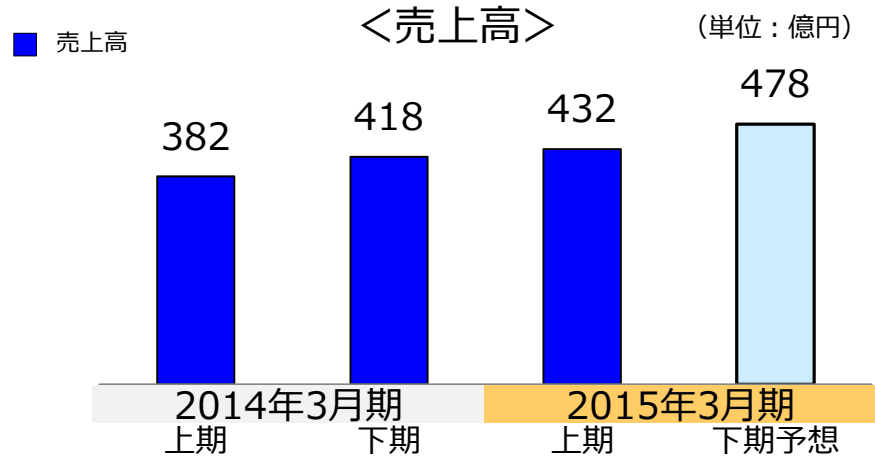
【変更無し】	2014年3月期		2015年3月期予想		前期比増減金額
	金額	構成比	金額	構成比	
ファインセラミック部品関連事業	80,020	5.5%	<b>91,000</b>	<b>5.7%</b>	10,980
半導体部品関連事業	187,891	13.0%	<b>224,000</b>	<b>14.2%</b>	36,109
ファインセラミック応用品関連事業	272,795	18.9%	<b>303,000</b>	<b>19.2%</b>	30,205
電子デバイス関連事業	284,322	19.6%	<b>291,000</b>	<b>18.4%</b>	6,678
部品事業 計	825,028	57.0%	<b>909,000</b>	<b>57.5%</b>	83,972
通信機器関連事業	186,749	12.9%	<b>205,000</b>	<b>13.0%</b>	18,251
情報機器関連事業	307,848	21.3%	<b>335,000</b>	<b>21.2%</b>	27,152
機器事業 計	494,597	34.2%	<b>540,000</b>	<b>34.2%</b>	45,403
その他の事業	173,137	11.9%	<b>178,000</b>	<b>11.3%</b>	4,863
調整及び消去	-45,393	-3.1%	<b>-47,000</b>	<b>-3.0%</b>	-1,607
売上高	1,447,369	100.0%	<b>1,580,000</b>	<b>100.0%</b>	132,631

# 2015年3月期 事業セグメント別事業利益予想

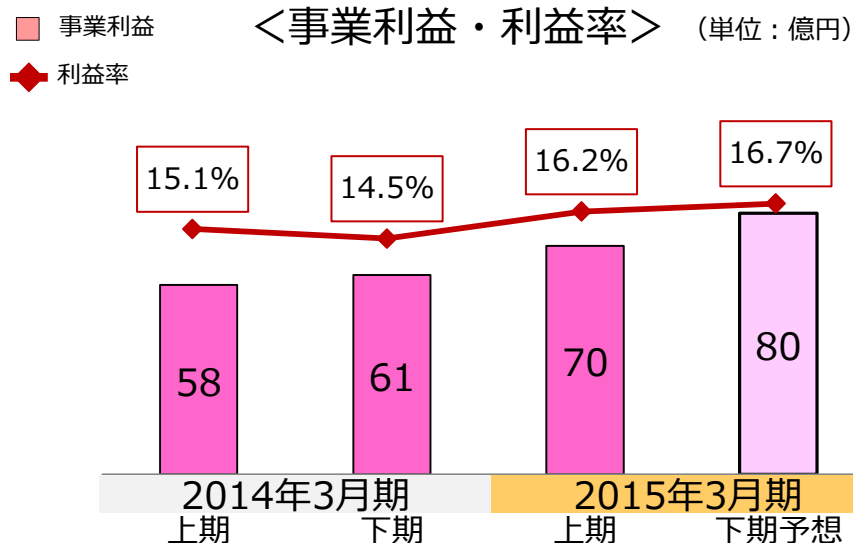
(単位：百万円)

	2014年3月期		2015年3月期予想				増減金額	
			前回予想 (4月時点)		今回予想 (10月時点)			
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	売上高比	前期比	前回予想比
ファインセラミック部品関連事業	11,836	14.8%	13,700	15.1%	<b>15,000</b>	<b>16.5%</b>	3,164	1,300
半導体部品関連事業	31,889	17.0%	33,600	15.0%	<b>33,600</b>	<b>15.0%</b>	1,711	-
ファインセラミック応用品関連事業	33,501	12.3%	30,300	10.0%	<b>15,000</b>	<b>5.0%</b>	-18,501	-15,300
電子デバイス関連事業	21,160	7.4%	28,900	9.9%	<b>35,900</b>	<b>12.3%</b>	14,740	7,000
部品事業 計	98,386	11.9%	106,500	11.7%	<b>99,500</b>	<b>10.9%</b>	1,114	-7,000
通信機器関連事業	1,437	0.8%	8,300	4.0%	<b>8,300</b>	<b>4.0%</b>	6,863	-
情報機器関連事業	28,193	9.2%	33,500	10.0%	<b>33,500</b>	<b>10.0%</b>	5,307	-
機器事業 計	29,630	6.0%	41,800	7.7%	<b>41,800</b>	<b>7.7%</b>	12,170	-
その他の事業	6,276	3.6%	6,400	3.6%	<b>6,400</b>	<b>3.6%</b>	124	-
事業利益 計	134,292	9.3%	154,700	9.8%	<b>147,700</b>	<b>9.3%</b>	13,408	-7,000
本社部門損益等	11,976	-	3,300	-	<b>10,300</b>	-	-1,676	7,000
税引前当期純利益	146,268	10.1%	158,000	10.0%	<b>158,000</b>	<b>10.0%</b>	11,732	-

# 2015年3月期下期 セグメント別業績予想 －ファインセラミック部品関連事業－



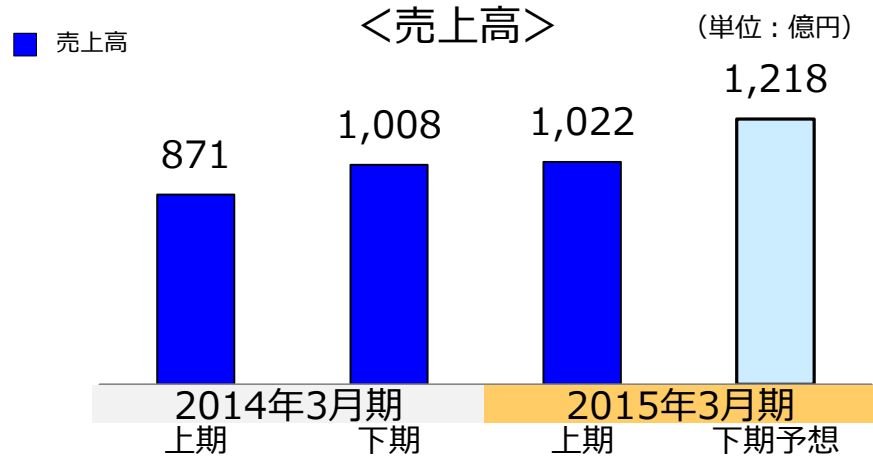
2015年3月期下期予想 (上期比)		
売上高	+46億円	+10.5%
事業利益	+10億円	+14.0%



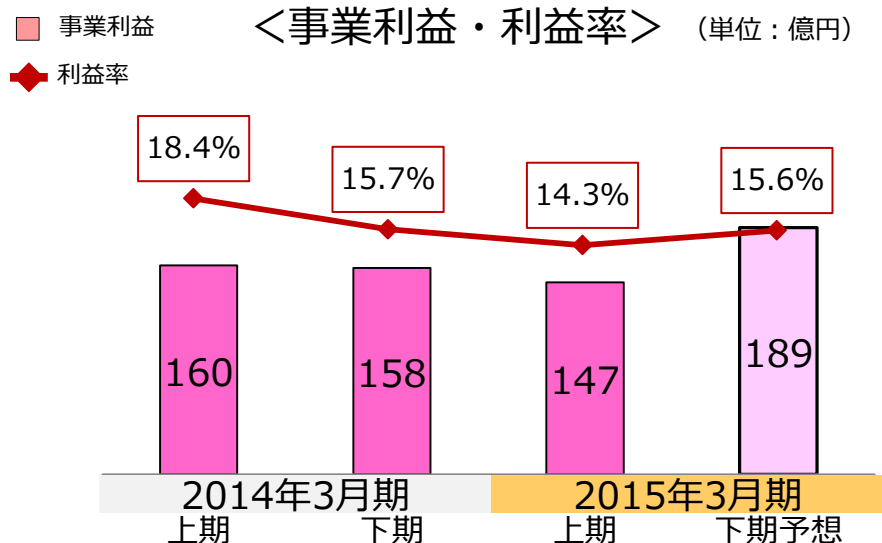
- 自動車関連部品の需要増
- 産業機械向け部品の売上増
- 原価低減による収益性の向上

# 2015年3月期下期 セグメント別業績予想

## －半導体部品関連事業－

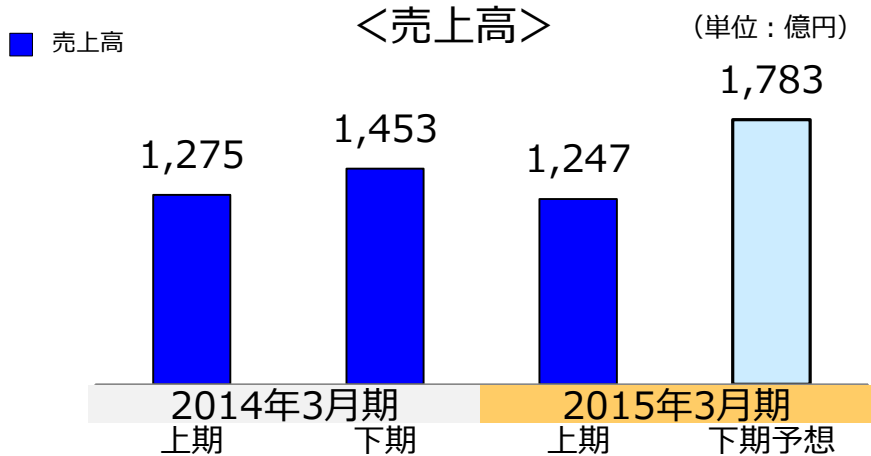


2015年3月期下期予想 (上期比)		
売上高	+ 196億円	+19.2%
事業利益	+ 42億円	+29.3%

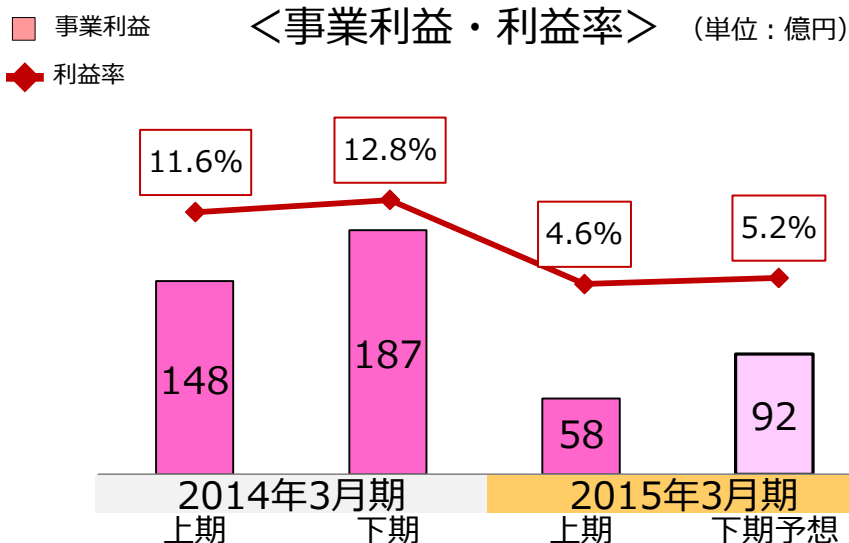


- スマートフォン向けセラミックパッケージの需要拡大
- 通信インフラ向けセラミック及び有機パッケージの売上増
- 有機基板事業2社の統合による製造・販売面での一層のシナジー追求
- 原価低減による収益性の向上

# 2015年3月期下期 セグメント別業績予想 - ファインセラミック応用品関連事業 -



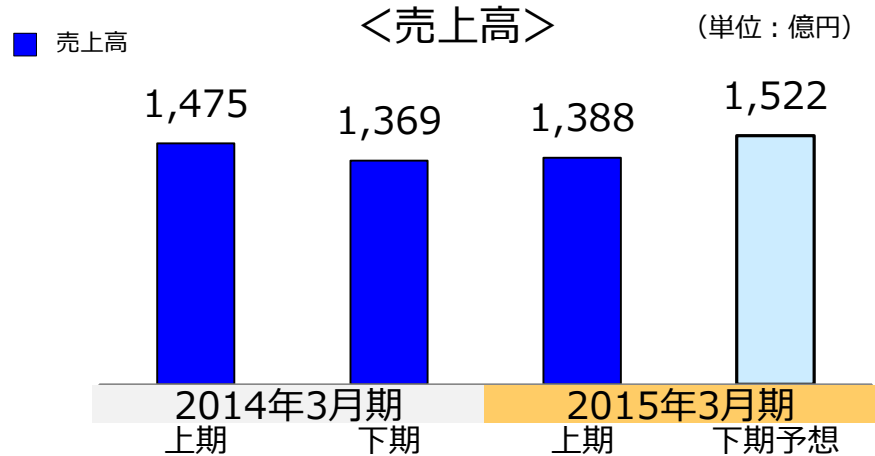
2015年3月期下期予想 (上期比)		
売上高	+ 536億円	+43.0%
事業利益	+ 34億円	+59.7%



- 産業用メガソーラー案件、住宅向け太陽電池等の売上拡大
- 自動車関連市場向け切削工具の販売拡大
- 原価低減による収益性の向上

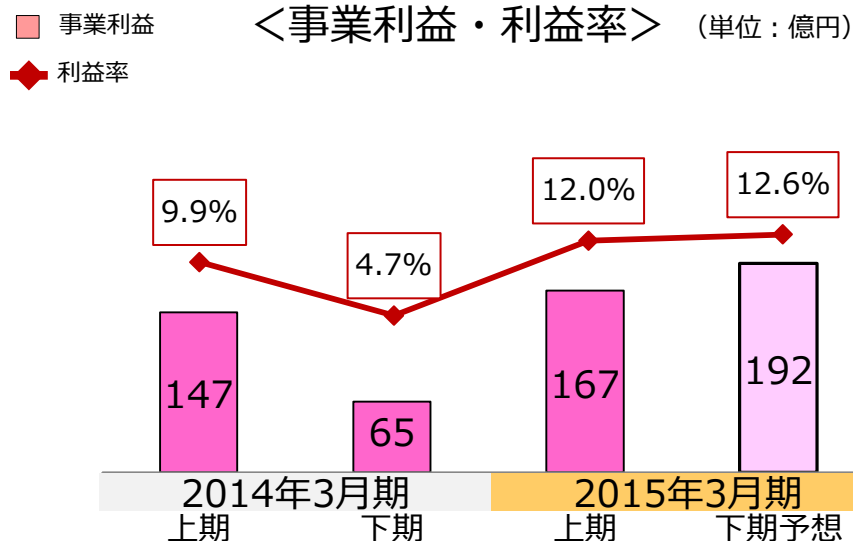
# 2015年3月期下期 セグメント別業績予想

## －電子デバイス関連事業－



### 2015年3月期下期予想 (上期比)

売上高	+ 134億円	+9.6%
事業利益	+ 25億円	+15.2%

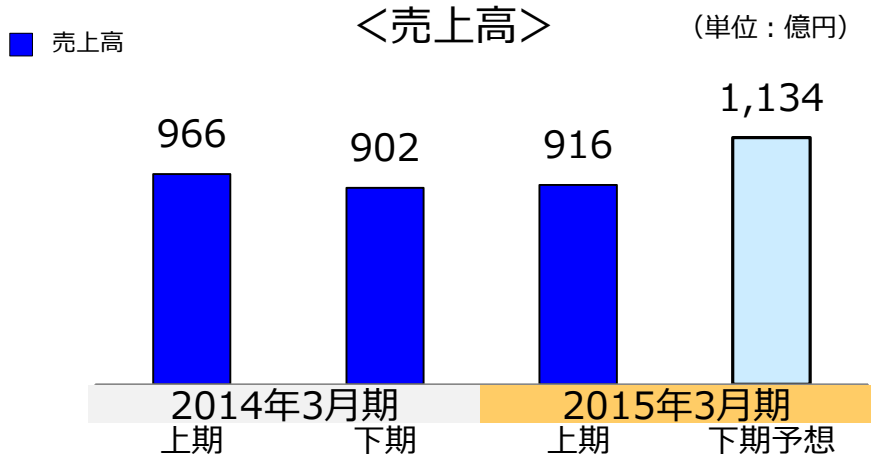


- ▶ スマートフォン等のデジタルコンシューマ機器に加え、産業機械市場向け等に各種部品を拡販
- ▶ 原価低減による収益性の向上



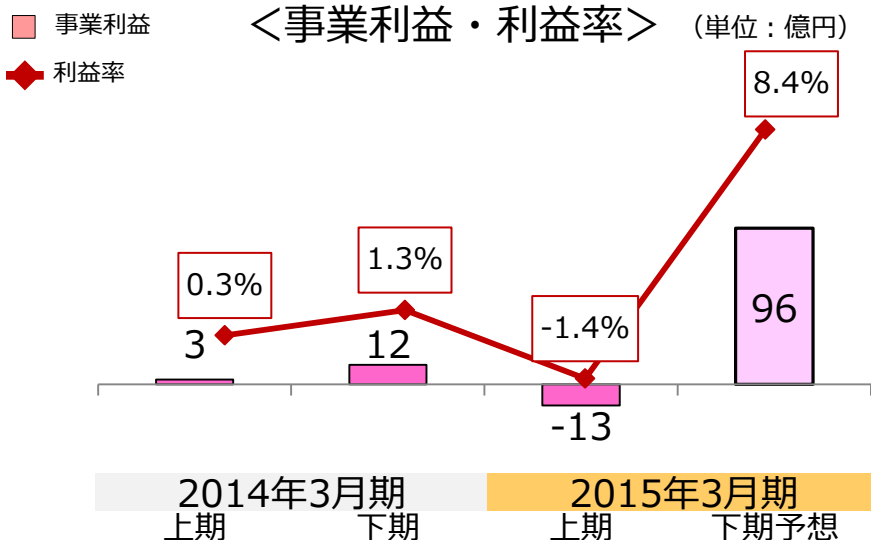
# 2015年3月期下期 セグメント別業績予想

## －通信機器関連事業－



### 2015年3月期下期予想 (上期比)

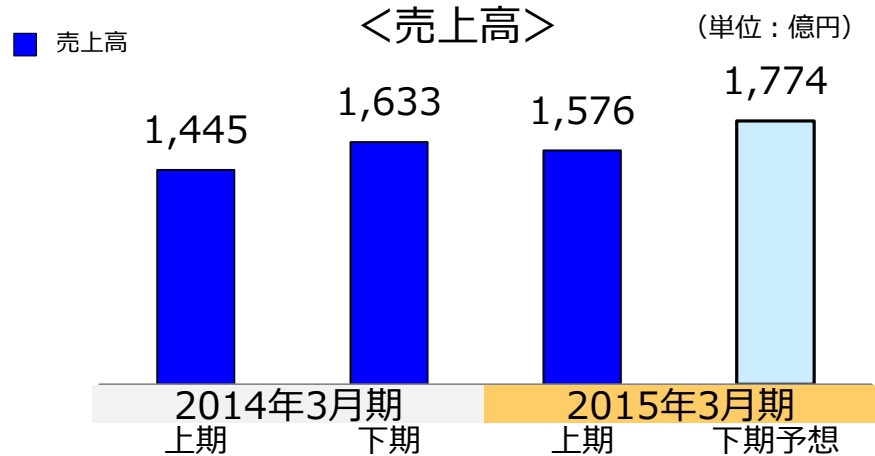
売上高	+218億円	+23.9%
事業利益	+109億円	－



- 新製品の投入による販売拡大
- 海外市場での新規顧客獲得
- プラットフォームの共通化による開発及び製造コストの低減

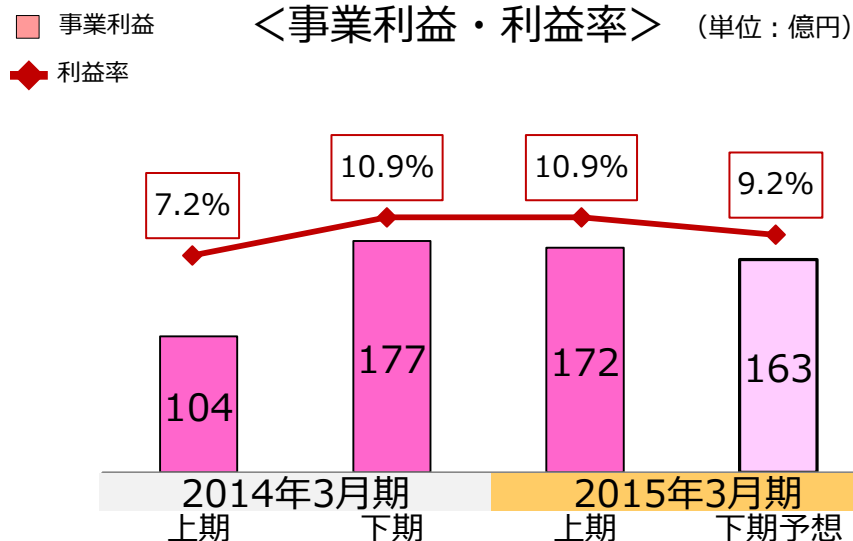
# 2015年3月期下期 セグメント別業績予想

## －情報機器関連事業－



### 2015年3月期下期予想 (上期比)

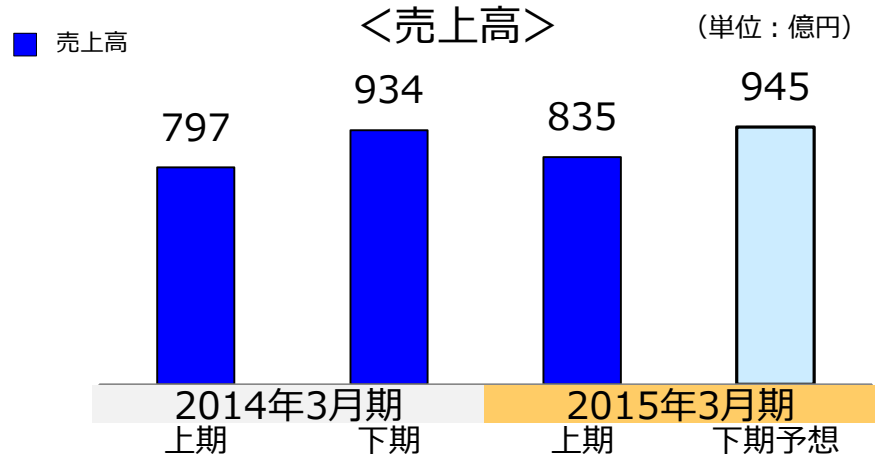
売上高	+ 198億円	+12.5%
事業利益	- 9億円	- 5.3%



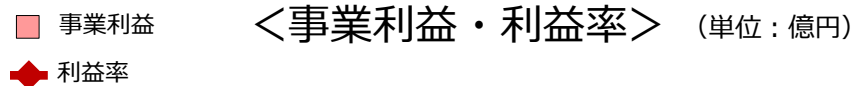
- 積極的な新製品投入及び拡販活動による  
海外市場での売上拡大
- 原価低減の推進

# 2015年3月期下期 セグメント別業績予想

## －その他の事業－



2015年3月期下期予想 (上期比)		
売上高	+110億円	+13.3%
事業利益	+14億円	+56.6%



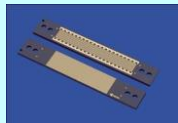
- 京セラコミュニケーションシステム及び京セラケミカルの売上、利益増

# 今後の取り組み（1）

## セラミックパッケージ事業の更なる拡大

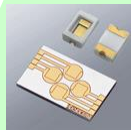
### 新市場の開拓

#### 医療等



CTスキャナ用  
基板

#### LED

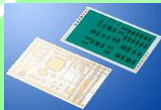


LED用パッケージ

#### 車載



センサー用  
パッケージ



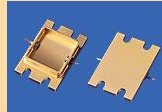
ECU用多層基板

#### 通信インフラ

データ通信の高速化による  
需要増



光及び無線通信用パッケージ



#### 通信端末

- ・他材料からの置き換えによるシェア拡大
- ・機器の小型・薄型化への対応

### セラミックパッケージへの要求

高放熱

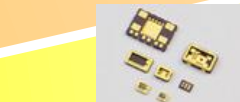
微細配線

高速化  
対応

小型・  
薄型化

多層化

多機能化  
対応



水晶・SAWデバイス用  
パッケージ



CMOSセンサー用  
パッケージ

### 更なる事業の強化

### 既存市場での シェアアップ

# 今後の取り組み（２）

## 有機基板事業でのシナジーの最大化及び経営基盤の強化

通信端末



スマートフォン

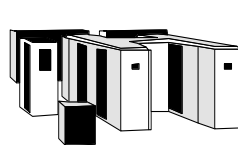
海外顧客  
への拡販

旧京セラSLCテクノロジーの販路

通信インフラ



通信基地局



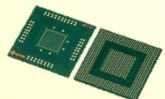
サーバー・  
ルーター



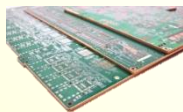
ストレージ

パッケージからマザーボードまで一括で  
有機基板ソリューションを提供

営業部門の統合



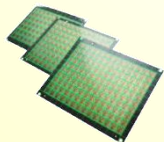
FCBGA



マザーボード



小型・薄型  
パッケージ（FCCSP）

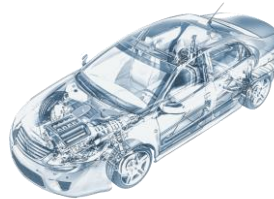


モジュール基板

旧京セラサーキット  
ソリューションズの販路

国内顧客  
への拡販

車載



生産体制の最適化



滋賀野洲工場から  
綾部新工場へ生産集約



最新設備による生産性向上

経営管理の強化

統一システムの導入

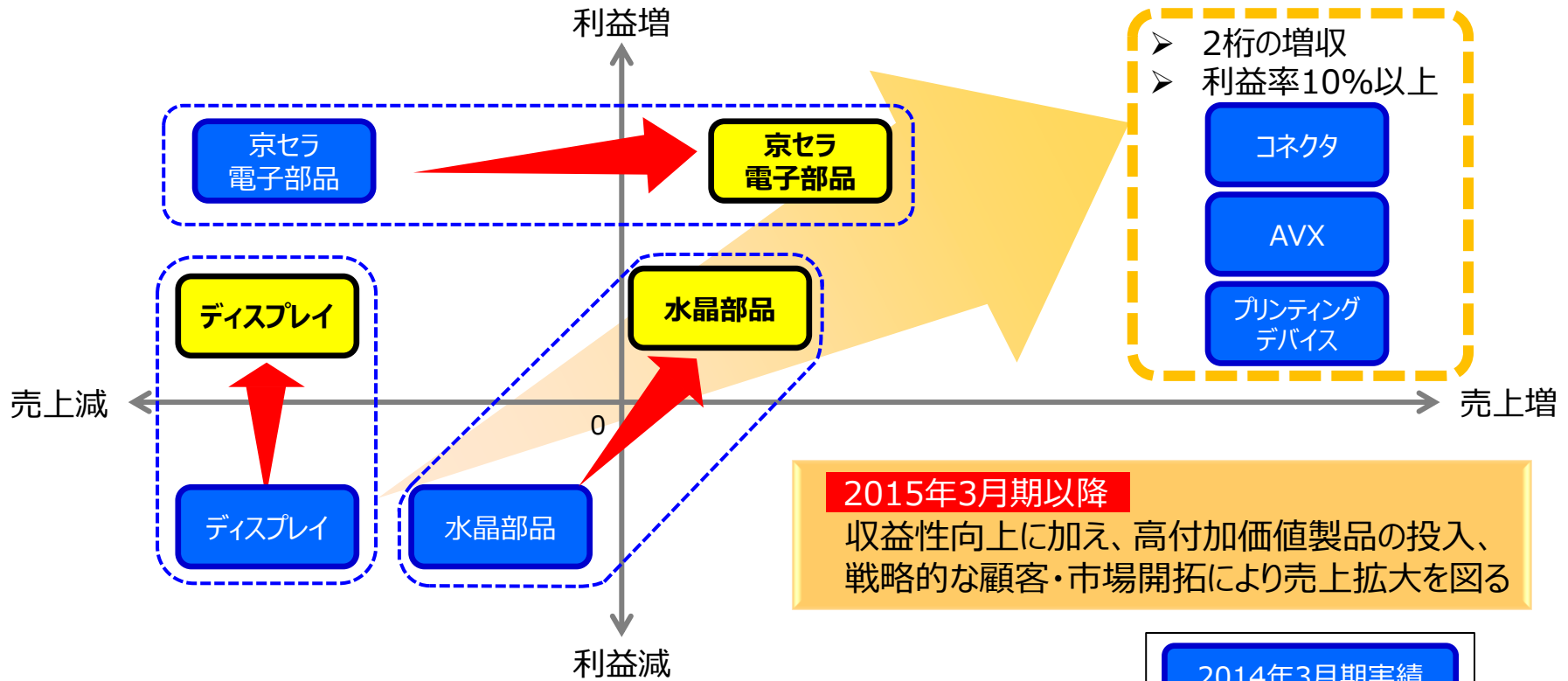


経営の効率化

# 今後の取り組み（3）

## 電子デバイス関連事業の収益向上

<主要製品の売上・利益の前期比増減>



**2014年3月期**

ディスプレイ、水晶部品、MLCC事業での構造改革を実施

➡ 注力する製品、分野へ経営資源を集中

2014年3月期実績

2015年3月期予想

# 今後の取り組み（４）

## 自動車関連市場での売上拡大

プロジェクトチームによる戦略的な取り組み



製品・顧客の拡大、高付加価値化



LCD

各種コンデンサ

水晶振動子

カメラモジュール

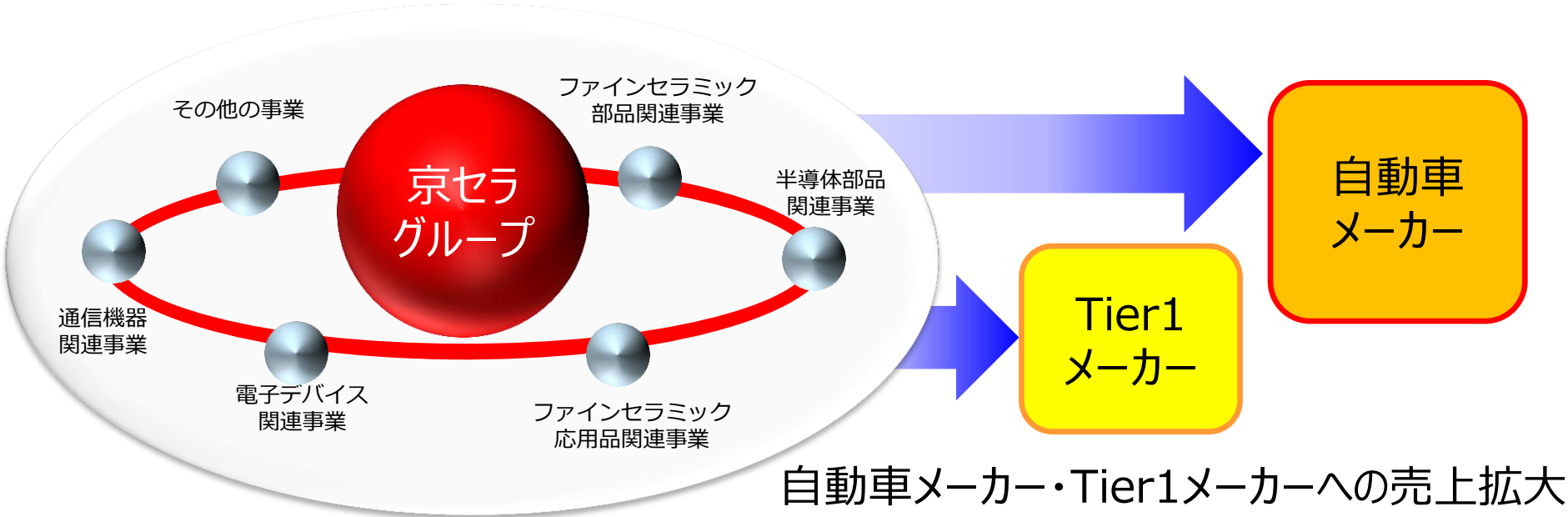
グロープラグ

切削工具

LED用  
パッケージ

通信モジュール

ECU用多層基板



自動車メーカー・Tier1メーカーへの売上拡大

# 経営目標

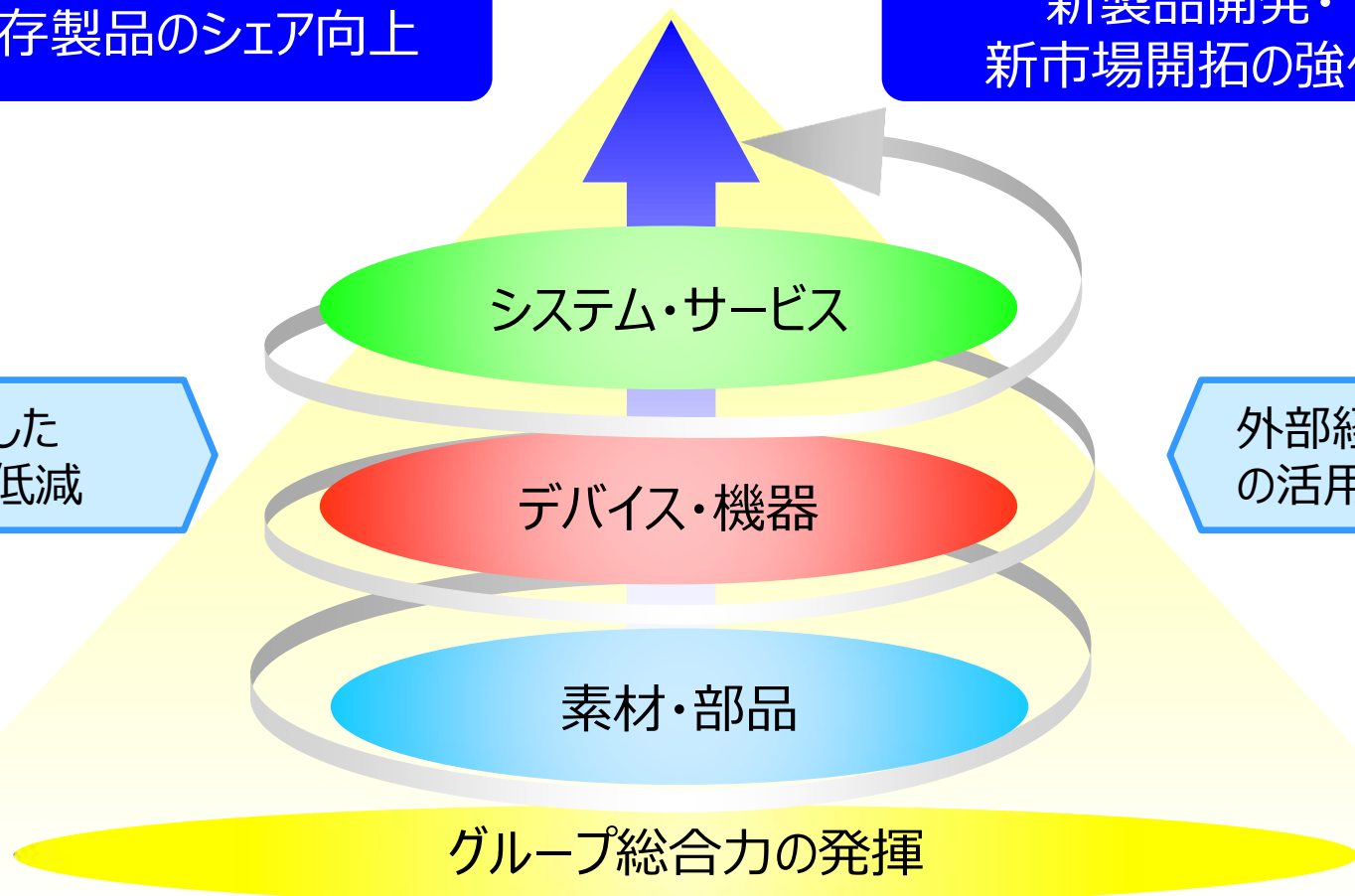
2桁の売上成長、10%以上の税引前利益率を目指す

既存製品のシェア向上

新製品開発・  
新市場開拓の強化

徹底した  
原価低減

外部経営資源  
の活用





## 将来予想に関する注意事項

この資料の記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(Forward-Looking Statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものです。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 日本及び世界経済の停滞による当社製品の需要の減退
- (2) 当社が事業を行う国及び地域における経済・政治・法律面の諸条件及びその想定外の変化
- (3) 円高、政治・経済情勢、関税及び不十分な知的財産権等の保護等が当社製品の輸出に及ぼす影響
- (4) 為替レートの変動が当社の海外資産の価値又は事業活動に及ぼす影響
- (5) 製品価格、技術革新、製品開発、品質、納期等の面における競争の激化
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 電力不足や電力費の上昇が当社の生産活動及び販売活動に及ぼす影響
- (8) 生産及び開発能力の拡大又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態
- (9) 買収した会社又は取得した資産から期待される成果や事業機会が得られない事態
- (10) 科学技術分野等の優れた人材の確保が困難となる事態
- (11) 当社の企業秘密が漏洩又は知的財産権が侵害される事態
- (12) 当社が知的財産権侵害に関連する要求又は特許実施許諾料の請求を受ける可能性
- (13) 国内外の環境規制による賠償責任の発生及び関連費用の負担
- (14) 意図しない法規制への抵触又は想定していない法規制の変更や導入が当社の事業活動を制約する状況
- (15) 疾病の発生、テロ行為、国際紛争等が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす悪影響
- (16) 地震等の自然災害及びこれに付随する災害によって当社の事業関連施設、サプライヤー及び顧客、並びに社会資本及び経済基盤等が甚大な被害を受ける事態
- (17) 当社の顧客の財政状態の悪化により売掛債権の回収が困難となる事態
- (18) 当社が保有する投資有価証券等の時価の下落に伴う減損処理の可能性
- (19) 当社の長期性資産、営業権、無形資産の減損処理の可能性
- (20) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (21) 会計基準の変更

これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。